

2019年9月2日

各位

テイカ株式会社

「ケミカルマテリアル Japan 2019」出展のお知らせ

当社は、2019年9月18日(水)～19(木)に、パシフィコ横浜で開催される「ケミカルマテリアル Japan 2019」に出展いたします。

長年培ってきた無機粒子合成技術、スルホン化技術等のコア・コンピタンスを応用した機能性製品や、新規開発した材料について展示いたします。

是非、当社ブースにお立ち寄りいただき、製品に触れていただきたいと思います。

会期 : 2019年9月18日(水)～9月19日(木) 9:00～17:00

会場 : パシフィコ横浜 C・Dホール(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

出展ブース : B-4

出展製品 : フィラーの表面改質技術、高機能性ナノ分散体

近紫外線吸収材料、蓄電デバイス用添加剤、微粒子活物質

新型微粒子酸化チタン、球状シリカ

スルホン化処理技術、導電性材料

圧電セラミックス、圧電単結晶

お問い合わせ先 : 東京支店 第一機能化学品課 (TEL 03-3275-0816)